

# 專利修正申請書範例 1

(本申請書格式、順序，請勿任意更動，※記號部分請勿填寫)

申請案號：100123456

※案由：21002

依據：101 年 12 月 3 日 (101) 智專二(一)09999 字第 10021234560 號函辦理。

同時辦理事項：變更申請人之  地址  代理人  代表人  姓名或名稱

簽章  其他：

一、發明(新型或設計)名稱：半導體裝置之製造方法

二、申請人：(共 1 人)(多位申請人時，應將本欄位完整複製後依序填寫，姓名或名稱欄視身分種類填寫，依法不須填寫的部分可自行刪除)

(第 1 申請人)

國籍： 中華民國  大陸地區 ( 大陸、 香港、 澳門)

外國籍：\_\_\_\_\_

身分種類： 自然人  法人、公司、機關、學校

ID：

姓名： 姓： 名：

Family  
name

Given  
name

(簽章)

名稱：(中文) 0000 股份有限公司

(英文) ABCD CO., LTD.

(簽章)

代表人：(中文) 000

(英文) 000

(簽章)

地址：(中文) 000000

(英文) 000000

聯絡電話及分機：

◎代理人：(多位代理人時，應將本欄位完整複製後依序填寫)

ID： Z123645879

姓名： 000

(簽章)

證書字號： 台代字第 0000 號

地址： 00 市 00 路 00 號 00 樓

聯絡電話及分機： (02)1234-5678 分機 0123

### 三、修正事項：

(請於所勾選修正說明事項之後，敘明修正理由，如字數過多者，請另以 A4 紙張直式橫書繕打，以附件標示並備具一式 2 份，俾利審查。)

說明書修正之頁數、段落編號及行數及修正理由：

#### 第 1 頁：發明名稱

「半導體裝置及其製造方法」修正為「半導體裝置之製造方法」

理由：修正發明名稱使其與申請專利之發明標的一致。

#### 第 1 頁第[0004]段第 1 行、第 10 頁第[0052]段第 5 行

「熱處理」修正為「退火處理」

理由：統一修正「熱處理」為說明書實施例第[0022]段所記之用語「退火處理」。

申請專利範圍修正之項號及修正理由：

#### 【第 1,5 項】

「熱處理」修正為「退火處理」

理由：統一修正「熱處理」為說明書實施例第[0022]段所記之用語「退火處理」。

「800 度以下」修正為「溫度介於攝氏 500~750 度間」

理由：將第 2,6 項之溫度併入第 1,5 項，以與 貴局所援引證區隔。

#### 【第 3,8 項】

將第 3,8 項誤植之「，」修正為「。」。

理由：為符合獨立項或附屬項之文字敘述以單句為之之規定。

#### 【第 2,6 項刪除】

理由：將第 2,6 項併入第 1,5 項。

#### 【第 11-20 項刪除】

理由：為刪除半導體裝置之請求，爰將第 11-20 項刪除。

【第 9-12 項新增】

理由：新增請求項第 9-12 項係依附於第 5 項，其所進一步界定之技術可見於說明書第[0028]文段之實施例內容所記之金屬矽化物遮罩層材料之選用群組及最佳為氧化矽，並未超出原申請時說明書、申請專利範圍或圖式所揭示之內容。

V 其他說明事項：

- 1、貴局所援引證 1,2，均未揭示或教示本案修正後之「第二次退火處理之溫度介於攝氏 500~750 度間」之技術，並且從本案說明書實施例第[0030]至[0032]段及圖 5 可以明確看出在該溫度間的退火處理具有降低金屬矽物電阻之功效。
- 2、引證 1 雖揭示了在源/極使用鎳金屬矽化物的技術，但是本案所請之使用鈷為源/極使用金屬矽化物與其明顯不同，…。
- 3、雖然貴局以引證 2 補足引證 1 未揭示之部分技術，然而其所揭示之多次退火之技術，仍與本案所載並且經過前後兩次不同溫度退火處理之技術不同，…。
- 4、引證 1,2 間也完全沒有合理的組合動機，…。
- 5、綜上所陳，經由上述之修正使本案所請各項發明符合專利法之規定，並且相較於引證 1,2，修正後之請求發明之製法步驟有較高的良率，不僅能避免習知接觸不良的缺失，且更能達到降低金屬矽化物電阻值之效果，實非發明所屬領域之通常知識者依引證 1,2 所能輕易完成者，應具有進步性。

四、附送書件：(不須填寫的部分可自行刪除)

( \* 個人資料保護注意事項：

申請人已詳閱申請須知所定個人資料保護注意事項，並已確認檢附之說明書、圖式、修正說明書、申復書及其附件(除委任書外)，不包含應予保密之個人資料；其載有個人資料者，同意智慧財產局提供任何人以自動化或非自動化之方式閱覽、抄錄、攝影或影印。)

1、本專利修正申請書一式 2 份。

2、發明專利修正部分劃線之摘要、說明書、申請專利範圍修正頁 1 份 (請於每頁右上角註記送件申請修正之日期)。

- 3、發明專利修正後無劃線之摘要、說明書、申請專利範圍及圖式替換頁(審查意見通知送達前一式3份，審查意見通知送達後一式2份)；如修正後致原摘要、說明書、申請專利範圍或圖式頁數、項號或圖號不連續者，應檢附修正後之全份摘要、說明書、申請專利範圍或圖式(審查意見通知送達前一式3份，審查意見通知送達後一式2份)(請於每頁右上角註記送件申請修正之日期)。

## 五、申請專利範圍請求項及規費之說明：

(一) 申請案(再審查案)發給第一次審查意見通知前，提出本次修正申請專利範圍者：

- 本案尚未提出實體審查申請，應繳規費不變。
- 本案已提出實體審查(再審查)申請，本次僅修正請求項，未有新增或刪除請求項之情事，應繳規費不變。
- 本案已提出實體審查(再審查)申請，本次有新增或刪除請求項者：  
新增 (     ) 項，刪除 (     ) 項，修正後共計 (     ) 項。  
本次應加收或退還規費共計新台幣 (     ) 元整。

(二) 申請案(再審查案)發給第一次審查意見通知後，提出本次修正申請專利範圍者：

- 本次僅修正或刪除請求項，未有新增請求項之情事，應繳規費不變。
- 本次有新增請求項者：  
新增 ( 4 ) 項，修正後共計 ( 12 ) 項。  
本次應加收規費共計新台幣 ( ZZ ) 元整。